산업통상자원부	보 도 자 료	http://www.motie.go.kr

2018년 6월 27일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 6. 26.(화) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2018. 6. 25.(월)	담당부서	전자부품과
담당과장	박영삼 과장(044-203-4270)	담 당 자	김성환 주무관(044-203-4276)

'반도체·디스플레이' & '바이오·의료기기' 산업 간 협력을 위한 전자부품 융합 얼라이언스 출범

□ **(행사개요)** 산업통상자원부는 **'18. 6. 26.(화) 한국반도체산업협회**(경기 분당)에서 **'전자부품 융합 얼라이언스 : 바이오·의료기기분과' 출범식과 업계 간담회를** 개최했다.

○ 이번 행사는 지난 5월 출범한 **'자동차 분과 전자부품 융합 얼라이언스'** 발족에 이은 **2번째**로,

- 반도체·디스플레이 업계와 수요자인 바이오·의료기기기업 간 **상시적으로 소통 할 수 있는 만남의 장**을 만들기 위한 것이다.

< 행사 개요 >

○ **(일시 / 장소)** '18.6.26(화) 14:00~15:40 / 한국반도체산업협회(경기 분당)

○ **(참석자)** 산업부 박영삼 전자부품과장, 한국바이오협회 오기환 이사, 한국의료기기공업협동조합 고재용 팀장, 전자부품연구원 강병모 기업협력본부장, 한국반도체산업협회 안기현 상무, 한국디스플레이협회 이상진 본부장, 중소·중견기업 임직원 등 약 20여명

□ **(의의) 바이오·의료기기**는 인체와 직접 접촉하는 경우가 많아 성능과 안전성에 대한 **높은 신뢰성이 요구**되어 제품 기획부터 임상시험을 거쳐 제품출시까지 **장기간, 고비용이 소요**된다.

○ 또한, **세계적인 업체가 시장을 선점**하고 있어 기술력과 신뢰성이 부족한 **우리 중소기업이 시장에 진입하는데 어려움**을 겪고 있다.

○ 이에 따라 산업부는 **반도체·센서 기술을 접목한 체외 진단분야** 등 **신시장**에서 **국내 업계가 초기시장에 빠르게 진입**할 수 있도록 바이오·의료기기 분야와 전자부품업계가 협력할 수 있는 **'전자부품 융합 얼라이언스(바이오·의료기기 분과)' 발족을 추진**했다.

□ **(핵심내용)** 「**전자부품 융합 얼라이언스**」는 기본적으로 **업계 자발적으로 운영**하며, **정부는 해외진출, 공동 연구개발(R&D)** 등을 지원할 계획이다.

① 구성원을 한정할 경우 지속가능성과 확장성에 어려움이 있을 수 있어 **구성원을 상시 모집**하는 **형태로 운영**하며, 이를 통해 **업종간 융합을 촉진**

② **해외 진출 지원**을 위해 각 산업별 국제 수요기업과 연계할 수 있도록 **'세계적 네트워킹 플랫폼 시리즈*에 참여**

* 예시(자동차): 비엠더블류(BMW) 등 세계적 기업을 초청, 국내 센서, 반도체 업계와 연계

③ 참여기업이 보유한 **새로운 사업 모델과 아이템을 홍보**할 수 있는 기회*를 제공

* 1:1 기업매칭 행사, 최종 수요기업 제품 홍보 등(연중)

④ 향후 추진될 **반도체·디스플레이 국책 연구개발(R&D) 프로젝트*에 업계 의견을 반영**할 수 있도록 운영할 계획

* 차세대반도체개발사업(기획중), 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업 (예타중)

□ 박영삼 전자부품과장은 인사말을 통해,

○ **반도체·디스플레이**는 진단과 수술의 정밀도와 정확도를 향상시킬 수 있는 **바이오·의료기기 산업경쟁력의 핵심요소**이므로,

○ 융합얼라이언스를 통해 **업계가 서로 생생 할 수 있기를 기대**하며, 정부도 **지속적으로 관심을 갖고 정책적으로 지원**하겠다고 말했다.

【붙 임】 1. 행사 개요 2. 얼라이언스 참여기관 현황

OPEN 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 김성환 주무관(☎ 044-203-4276)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 행사 개요

□ 행사 개요

○ (목적) 전자부품 융합 얼라이언스 **바이오·의료기기분과 운영을 위한 출범식 및 업계 의견 청취를 위한 간담회 개최**

○ (일시/장소) '18.6.26일(화) 14:00~15:40 / 반도체협회(판교)

○ (참석자) 산업부, 전자부품연구원, 한국바이오협회, 한국의료기기공업협동조합, 한국반도체협회, 한국디스플레이협회 등

○ (주요내용)

- 전자부품 얼라이언스 운영계획 발표
- 참여기업 간담회

□ 세부 계획(안)

시 간	내 용	비 고
14:00~14:10(10')	- 인사말씀	· 박영삼 과장
14:10~14:25(15')	- 얼라이언스 출범 그간 경과 및 향후 계획 발표	· 전자부품연구원
14:30~15:30(60')	- 얼라이언스 신청기업 간담회	· 참석자
15:30~15:35(5')	- 마무리말씀	· 박영삼 과장
15:35~15:40(5')	- 기념촬영	· 참석자

붙임2 전자부품 융합 얼라이언스(바이오·의료기기분과) 참여기관 현황

□ 반도체·디스플레이·바이오·의료기기 기업, 연구기관 등으로 구성

구분	소속	성명	직책	비고
주관기관	전자부품연구원	강병모	기업협력본부장	
		성우경	휴먼케어시스템연구센터장	바이오·의료기기분과 간사
참여기관	산업기술평가관리원	손광준	반도체PD	
		박영호	디스플레이 PD	
	한국반도체산업협회	안기현	상무	
	한국디스플레이산업협회	이상진	본부장	
	한국바이오협회	오기환	이사	
	한국의료기기공업협동조합	고재용	팀장	
참여기업	㈜보템	김동철	연구소장	바이오·의료기기(5)
	㈜멕아이씨에스	이상학	연구소 상무이사	
	원텍(주)	서영석	연구소장	
	오상헬스케어	이규원	팀장	
	삼성전자 의료기기사업부	송종근	수석연구원	
	에이디칩스	이희	부사장	반도체(4)
	테크위드유	김형래	대표	
	옵토레인	이도영	대표	
	센소니아	홍순원	대표	
	파인텍	서인용	부장	디스플레이(10)
	우리마이크론	박노선	부사장	
	한국알박	윤기영	상무	
	케이씨텍	박경화	부사장	
	패터니아(주)	이만환	팀장	
	다원시스	형정우	사원	
	인베니아	박우종	팀장	
	이엘케이	이덕영	수석	
	에스엔텍	허승회	연구소장	
		최상대	수석	
	와이티에스	차영식	수석	
		홍성준	차장	